Проектирование многослойных и гибко-жестких печатных плат

Технологии BGA*, HDI** и их поддержка в САПР Mentor Graphics.

16 июня 2009 г. в 10.00 в МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского (г. Москва) состоится семинар для разработчиков печатных плат, посвященный вопросам проектирования многослойных плат с глухими и скрытыми отверстиями (МПП HDI), а также многослойных гибко-жестких плат (ГЖПП).
Будут рассмотрены технологические возможности современных производителей печатных плат, а также их поддержка в маршруте проектирования САПР Mentor Graphics.

9.20-10.00	Сбор и регистрация участников семинара.
10.00-11.20	Акулин А.И. Проектирование многослойных печатных плат с BGA-компонентами. Реализация требований технологичности и тестопригодности (DFM, DFA, DFT).
11.30-12.50	Чен Бэй. Технологические возможности современного завода, специализирующегося на производстве многослойных и гибко-жестких печатных плат высокой плотности. Особенности подготовки проектов.
12.50-13.30	Обед
13.30-14.50	Лохов А.Л. Обзор решений Mentor Graphics в области САПР электроники.
15.00-16.20	Филиппов А.А. Обзор маршрута проектирования Expedition. Создание схемы проекта. Параллельное проектирование. Библиотеки компонентов и управление базами данных проекта. Интеграция с проектированием ПЛИС. Новые методы трассировки (BGA Fanout, Team/Xtreme PCB, Topology Router, ATP Flex). RF-проектирование. Подготовка производства.
16.30-17.50	Рабоволюк А.В. Вопросы функционального и электрического моделирования систем на печатных платах.

Организаторы семинара:

- Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов (АПЭАП)
- МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского
- Компания Мегратек (дистрибьютор САПР Mentor Graphics)
- Компания ПСБ технолоджи (поставщик многослойных печатных плат)
- КБ «Схематика» (дизайн-центр по разработке печатных плат на заказ)

При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ

Стоимость участия:
Бесплатно для юридических лиц, с обязательной предварительной регистрацией.
Количество мест в зале ограничено, регистрируйтесь заранее!
Регистрация участников семинара: http://www.pcbtech.ru/seminar
Тел./факс: (495) 781-63-88 доб. 109
Контактное лицо: Оксана Демидова
Место проведения семинара: г. Москва, Берниковская наб., д. 14
МАТИ-РГТУ им. К.Э.Циолковского, 5 этаж, актовый зал. Вход по спискам.
Проезд: от станции метро "Таганская (кольцевая)" пешком по ул. Земляной Вал до Берниковской набережной.

** BGA (ball grid array) – тип корпуса компонентов с шариковыми выводами, предполагающий более сложный, чем обычно, процесс проектирования, изготовления и монтажа печатных плат*

*** HDI (high density interconnect) – технология изготовления многослойных печатных плат повышенной плотности, с применением лазерных микроотверстий и скрытых отверстий*

PCBtechnology

megratec MENTOR GRAPHICS TECHNOLOGIES